

附件一

## 电子元器件自查承诺书

依据ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件自主可控评估通用准则》和ZKB 3101-002-2024《武器装备使用国产电子元器件“伪、空、包”产品判定准则(试行)》的相关要求，我单位针对研制生产的电子元器件产品开展自主可控等级和“伪、空、包”情况自查及评估。结果如下：

自查产品共\_\_ 3 \_\_项，其中自主可控A级\_\_ 0 \_\_项、B级\_\_ 3 \_\_项、C级\_\_ 0 \_\_项、C\*级\_\_ 0 \_\_项、D级\_\_ 0 \_\_项、E级\_\_ 0 \_\_项；伪国产化\_\_ 0 \_\_项、包装国产化\_\_ 0 \_\_项、空心国产化\_\_ 0 \_\_项。

电子元器件“伪、空、包”审查基本信息填写表详见附表一；电子元器件使用IP核情况、原材料和零部件、工艺流片等基本情况填写表详见附表二。

我单位承诺以上内容真实有效，自愿承担一切后果。

特此承诺。



附表一

电子元器件“伪、空、包”审查信息一览表

序号	元器件名称 <sup>a</sup>	型号规格 <sup>b</sup>	生产厂商 <sup>c</sup>	自主可控等级 <sup>d</sup>	是否“伪国产化” <sup>e</sup>		是否“包装国产化” <sup>e</sup>		是否“空心国产化” <sup>e</sup>		备注 <sup>e</sup>
					是/否	情况说明	是/否	情况说明	是/否	情况说明	
1	运算放大器	JTLXA193XF	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
2	运算放大器	JTLXA193XF(W)	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
3	运算放大器	TLXA193XF	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	

填表说明：

- <sup>a</sup>.应是元器件全称，与详细规范或产品技术资料上的名称相符；
- <sup>b</sup>.应填写元器件完整型号规格；
- <sup>c</sup>.应填写元器件生产厂商中文全称，勿填写代理商；
- <sup>d</sup>.按照ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件自主可控评估通用准则》执行，分为A、B、C、C\*、D、E六个等级，针对为军选民用计算机设备等配套的中央处理器、图形处理器、网络交换芯片、网络处理器芯片、网络控制器芯片、存储控制器芯片按照GJB 9530执行；
- <sup>e</sup>.“伪、空、包”应按照ZKB3101-002-2022标准执行。若为“是”时，则需要“情况说明”写明判别因素；若为“否”时，则填“无”；

3202110176104

无锡泰连芯科技有限公司

填报单位（盖章）： 法定代表人（签章）： 填表人（签字）： 电话：18221090182 填报日期：202510

f.若存在其他需要说明的情况，可在备注栏填写。



填报单位（盖章）：

法定代表人（签章）：

汤学明

填表人（签字）

姜春雷

电话：18221090182

填报日期：202510

附表二

电子元器件基本信息表

序号	元器件名称 <sup>a</sup>	型号规格 <sup>b</sup>	使用IP核情况 <sup>c</sup>				原材料和零部件 <sup>d</sup>				流片工艺 <sup>g</sup>		备注
			名称	类型	来源单位	境内/境外	名称	是否“核心”/“关键” <sup>e</sup>	来源单位 <sup>f</sup>	境内/境外	工艺名称	境内/境外	
1	运算放大器	JTLXA193XF	IP核1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.35um CMOS	境内	
			IP核2	/	/	/	封装	/	天水华天				
2	运算放大器	JTLXA193XF(W)	IP核1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.35um CMOS	境内	
			IP核2	/	/	/	封装	/	天水华天				
3	运算放大器	TLXA193XF	IP核1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.35um CMOS	境内	
			IP核2	/	/	/	封装	/	天水华天				

填表说明：

- <sup>a</sup>.应是元器件全称，与详细规范或产品技术资料上的名称相符；
- <sup>b</sup>.应填写元器件完整型号规格；
- <sup>c</sup>.仅适用于半导体集成电路，应填写IP核类型，包括“软核”“固核”“硬核”；
- <sup>d</sup>.本表中应填报的原材料和零部件应根据实际情况填写，至少包含ZKB 3101-002-2022标准附录A中内部零部件或原材料，同时也应包含外壳、引出端、键合丝等，不包含灌封料等生产过程材料；
- <sup>e</sup>.应根据ZKB 3101-002-2022标准附录A填写“核心”或“关键”，非“核心”或“关键”原材料和零部件此项不填；
- <sup>f</sup>.应根据实际设计单位或生产商情况填写，不能按代理商填写；对来源不明的，应填写“来源不明”，具体判定时视为“境外”；

填报单位（盖章）：

法定代表人（签章）：

填报人（签字）：

电话：

填报日期：202510

9.仅适用于半导体集成电路，应填写流片工艺名称，如45nmBCD工艺等，必要时在备注中填写流片厂商信息。



填报单位（盖章）：

法定代表人（签章）：

汤学明

填表人（签字）

姜春雷

电话：18221090182

填报日期：202510